

项目名称： 高电流脉冲电光源      PSS_HCPL			项目负责人： 胡国锋							
项目关键阶	阶段目标	周	项目子阶段	任务目标及要求		人员要求		开始时间	截止时间	备注
软硬件设计 /2021-05-14	(1) 硬件完成所有板卡设计：模拟板五一节前投板，12号PCBA回；其它板卡在节后5月11日前全部投出； (2) 系统方案确定，软件需求明确；并在5月14日前完成FPGA功能代码；	18	模拟板设计	模拟板完成投板（5月12日前PCBA回板）		硬件	田振		2021/4/28	
			所有板卡的原理图设计完成			硬件	田振	2021/4/29	2021/4/30	
			立项评审与系统方案评审			硬件	胡国锋	2021/4/29	2021/4/30	
			软件需求梳理与确认			硬件	胡国锋	2021/4/29	2021/4/30	
		19-20	除模拟板外的其它硬件板卡完成投板	电容板+功率开关板卡（缓启动+泄放）	硬件	田振	2021/5/6	2021/5/11	(1) 根据实际情况确定那些板卡优先； (2) 如果风险可控，底板应先投，最好能17日前回板（PCBA），配合	
				底板（光功率检测板和供电板留出位置）	硬件	田振	2021/5/6	2021/5/11		
				系统供电板	硬件	田振	2021/5/6	2021/5/11		
				控制板	硬件	田振	2021/5/6	2021/5/11		
				DUT电压检测板	硬件	田振	2021/5/6	2021/5/11		
				接口板（输出端子板+接触器承载板）	硬件	田振	2021/5/6	2021/5/11		
			结构件完成设计并打样			结构	江波	2021/5/6	2021/5/11	
			模拟板初测	确认单板功能		硬件	田振	2021/5/12	2021/5/14	
			上位机界面完成规划和设计					2021/5/6	2021/5/14	
			FPGA逻辑部分完成功能设计					2021/5/6	2021/5/14	
功能验证 /2021-05-21	(1) 软件代码全部就绪； (2) 模拟板基本功能实现； (3) 所有硬件板卡和结构件全部回司；	21	模拟板完成并联大电流输出功能调试			硬件	田振	2021/5/7	2021/5/21	
			软件完整功能代码完成（上位机+FPGA+软							
			所有硬件板卡（PCBA）和结构件回司					2021/5/21		
软硬件联调与初测完成 /2021-05-28	(1) 单板功能初测完成； (2) 软硬件联调完成； (3) 完成功能测试；	22	软硬件联调					2021/5/21	2021/5/28	

说明：此项目计划为初步项目计划，关键时间截点不应变动，周任务可根据紧急程度调整实际开始/截止时间，具体时间人员安排据每周项目组例会会议而定。

主要目的：

1、理清项目执行思路，划清各子任务截点

2、初步预估人力、时间交叉冲突，做出合理安排